

聯華電子股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(金額除另予註明外，均以新臺幣千元為單位)

本公司於民國一〇七年一月十二日在大陸福州市中級人民法院，對美光半導體(西安)有限責任公司與美光半導體銷售(上海)有限公司等提起三件侵害專利權訴訟，請求法院判令該等被告停止製造、加工、進口、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的行為，銷毀全部庫存及相關模具及工具。大陸福州市中級人民法院於民國一〇七年七月三日對上述兩家被告公司等發出初期禁令，裁定上述兩家被告公司等立即停止製造、銷售及進口侵害本公司專利權之多項產品。法院已批准本公司撤回其中一項訴訟，其他兩項訴訟案仍由法院審理中。達成全球性和解協議後，本公司已向法院遞交撤訴及撤銷保全申請，目前等待法院裁定。

上述法院判決之罰金及全球性和解協議之和解金對於本公司之財務及業務無重大影響，且已認列於業外其他損失。

十、重大之災害損失

無此事項。

十一、重大之期後事項

無此事項。

十二、其 他

1. 金融工具之種類

金 融 資 產	112.03.31	111.12.31	111.03.31
透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$18,807,797	\$18,490,569	\$22,332,406
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,263,433	15,189,600	18,169,220
按攤銷後成本衡量之金融資產			
現金及約當現金(不含庫存現金)	171,828,423	173,812,754	172,164,484
應收款項	28,903,999	38,783,086	38,822,973
存出保證金	2,749,664	2,749,691	2,390,529
其他金融資產	266,755	869,308	3,035,663
合 計	<u>\$240,820,071</u>	<u>\$249,895,008</u>	<u>\$256,915,275</u>
金 融 負 債			
透過損益按公允價值衡量之金融負債	\$782,936	\$438,397	\$1,158,090
按攤銷後成本衡量之金融負債			
短期借款	100,000	-	1,339,861
應付款項	55,730,821	58,893,871	39,295,080
存入保證金(含一年內到期)	32,553,535	30,757,001	14,793,909
應付公司債(含一年內到期)	28,230,606	28,184,687	33,543,167
長期借款(含一年內到期)	18,746,774	19,279,342	37,761,909
租賃負債	5,728,342	5,737,095	5,049,227
其他金融負債	21,577,420	21,449,487	21,798,655
合 計	<u>\$163,450,434</u>	<u>\$164,739,880</u>	<u>\$154,739,898</u>